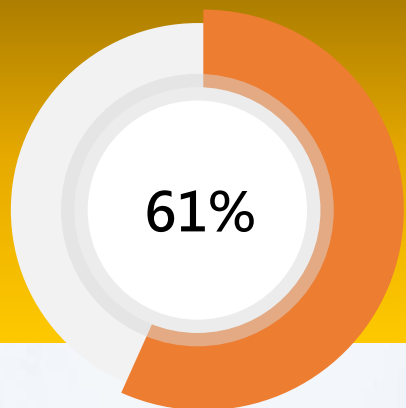


2024

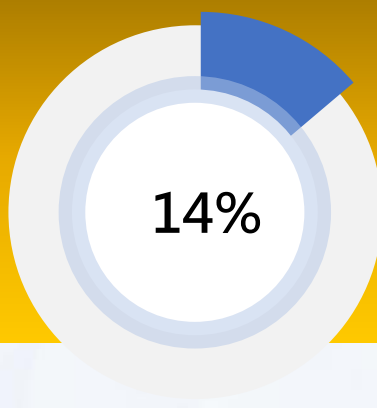
化合物半導體國際論壇 贊助方案



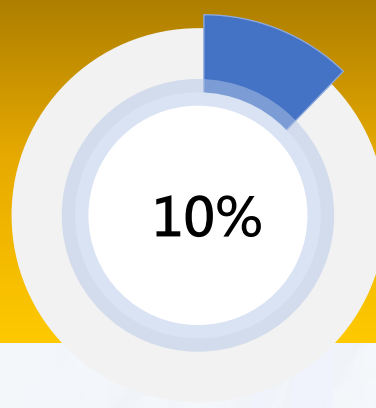
與會者產業分析



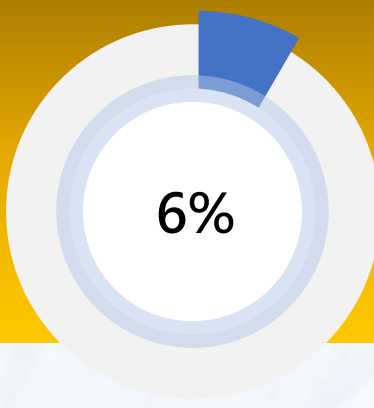
半導體



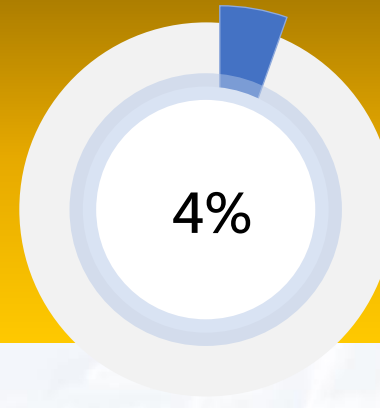
光電



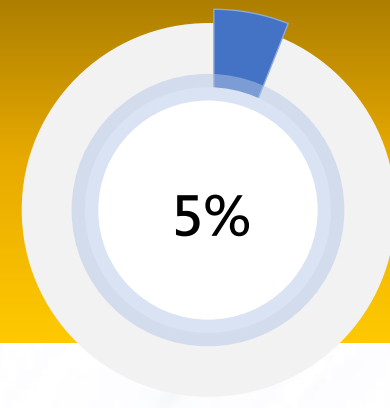
學研單位



電腦週邊

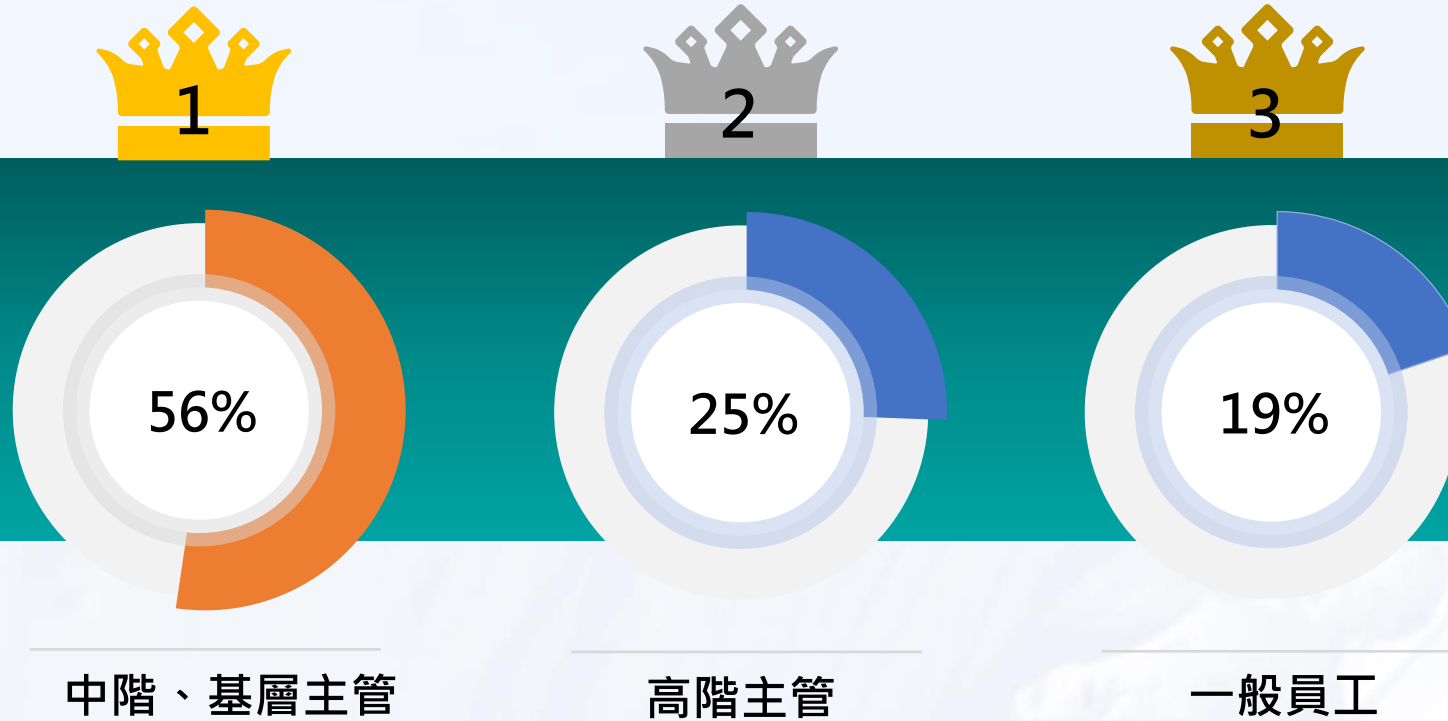


金融投信



其他

與會者職位分析



2022 第三代半導體國際論壇 成果

台灣電子設備協會(TEEIA)、國立台灣大學工學院(NTU)共同合作，舉辦「**第三代半導體國際論壇**」，邀請了許多國內外重量級講師，分享第三代半導體產業發展現況、市場趨勢解剖及長晶材料的製造與加工探討，講師陣容包含**Wolfspeed**、**意法半導體(ST)**、**Disco**、**GaN systems**、**環球晶**、**漢磊**、**尼克森**、**YOLE**、**碣砂電子**、**盛新材料**、**優貝克**、**陽明交通大學**等海內外知名大廠，整天活動吸引了將近200人前來交流，期待未來這個產業的發光發熱。



Wolfspeed

GaN Systems

ST
life.augmented

GW

GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

NIKO-SEM
尼克森微電子

YOLE
Intelligence

SiCEV

ULVAC

盛新材料科技
TAISIC MATERIALS CORP.

KLA+

SCIENTECH

國立陽明交通大學
NYCU

PRECISION CO.
元 鋒 精 密

AXTRON
Our technology. Your future.

EMRD

SURUGA
SEIKI

EPISIL

CMit

APPLIED
MATERIALS

LATENTEK

UKTECH
昱凱科技股份有限公司
U.K. TECHNOLOGY CORP.

ECM
GREENTECH

2023 化合物半導體國際論壇 成果

碳化矽(SiC)產業鏈已經成為世界各國重點布局的戰略性產業，2023『化合物半導體國際論壇』邀請了許多指標性國際大廠前來分享：辛耘、Wolfspeed、英飛凌、世界先進、Disco、Yole、碳矽電子、Electroninks、OnSemi、Soitec、PALLIDUS，從不同面向探討化合物半導體的發展脈動，並搭配Touch Taiwan化合物半導體主題館進行導覽活動，不只有「聽」論壇，更能實際用眼睛去「看」，與會來賓與參展商互動熱烈，共同建構化合物半導體產業生態圈。

現場累計將近200人與會



英飛凌



歷屆講師陣容大集合



莊淵棋 副總經理
GaN Systems



程泰慶 經理
漢磊科技



許至全 銷售及市場部副總裁
亞太區(不含中國) Wolfspeed



謝智正 處長
尼克森微電子



陳文聰 亞太區功率元件技術行銷經理
意法半導體



郭浩中 講座教授
國立陽明交通大學



劉建廷 業務經理
迪思科高科技



林柏丞 執行長特助
盛新材料



張家棟 經理 ULVAC



魏致祺 資深協理 英飛凌



李宏益 行銷事業群總經理
辛耘企業



李坤彥 創辦人 碳矽電子



Melbs LeMieux
聯合創辦人/總裁
Electroninks



江明松 應用工程經理
安森美半導體



Walter Schwarzenbach
PhD. Soitec



方建雄 總經理
PALLIDUS



邱建維副處長 世界先進



Claire Troadec Director,
Power & Wireless
Yole Développement

贊助方案

項目內容		銀級	金級
演講 (主辦單位保留安排議程與時間“30分鐘”權利) * 海外講師可使用線上直播或錄影檔案		無	○
TEEIA官網首頁	專屬banner輪播 *30天(含假日)	○	○
網路曝光	公司介紹文 *Facebook：1圖+文字200內	○	○
	會後報導(含外稿記者)	無	○
論壇講義封面/內頁/(公司 Logo/介紹)		○	○
會場佈置看板Logo		○	○
特製看板(100x200cm)		無	○
企業瓶裝水(24瓶/10箱)		無	○
論壇VIP公關票		2張	5張
化合物半導體供應鏈之夜 門票		1張	2張
原價(不含營業稅)		請洽主辦單位	
參展商、會員優惠價(不含營業稅)		請洽主辦單位	

贊助方案

贊助項目	主辦單位提供配套	贊助費用	贊助商數量
化合物半導體供應鏈之夜	■ TEEIA官網首頁：專屬banner輪播 (30天/含假日) ■ 品牌曝光：會議開始前及休息時間播放3分鐘宣傳片(影片檔由贊助廠商自行提供) ■ 大會主背板Logo曝光 ■ 贊助單位推派代表上台致詞(5分鐘內) ■ 論壇VIP公關票 名額5人 ■ 化合物半導體供應鏈之夜 門票2張 ■ 晚宴規模：80人	請洽主辦單位	單一企業冠名贊助

- 主辦單位保留變更內容之權利
- 晚宴之贊助廠商，將於化合物半導體供應鏈之夜頒發獎牌一座

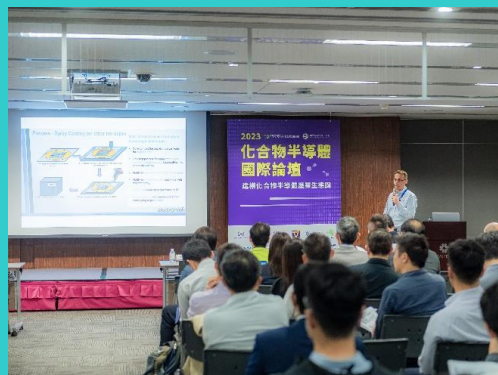
3. 網路曝光

4. 企業瓶裝水

2. 社群廣告

1. 演講

時間30分鐘



4. 首頁曝光，有效提升點閱率

贊助廠商專屬banner(圖檔由廠商提供)

5. 會場佈置看板Logo

6. 化合物半導體供應鏈之夜



EDM/社群軟體 成效

(活動前一個月宣傳，能聚集到最多參與者)

(1) EDM

活動前：四次發送

成功發送: 75,165 / 開啟率: 27.01% / 點選率: 15.99%

成功發送: 77,120 / 開啟率: 25.5% / 點選率: 13.62%

成功發送: 10,250 / 開啟率: 24.43% / 點選率: 16.28%

成功發送: 71,400 / 開啟率: 25.13% / 點選率: 14.91%

發送數量100,000筆 以上
平均開信率10-20%

(2) 社群軟體 〈Facebook〉



曝光次數：36,923人

貼文觸及人數：24,052人

活動資訊觸及率超過2萬人

(3) 社群軟體 〈Line〉



群組成員：TEEIA會員廠商
高階主管(經理級以上)>350人

平均觸及人數：300人

EDM宣傳

SiC的產業化之路

第3代半導體

International Compound Semiconductors Conference 2022 國際論壇

2022. 4/28 THU
TIME 9:30-17:10

報名請掃QR CODE

第一場次 第三代半導體的市場與應用

GaN Systems
莊潤祺 Andy Chuang
VP of Business Development
GaN Systems

漢磊科技
程泰慶 Rem Cheng
Sales Account Manager
EPISIL TECHNOLOGIES INC.

WolfSpeed
許至全 Bruce Hsu
Director - Asia Regional Sales
WOLF SPEED TAIWAN LIMITED.

尼克森微電子
謝文聰 Alvin Chen
Director
NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.

意法半導體
陳文聰 Alvin Chen
Technical Marketing Section Manager,
Power Discrete, APAC, STMicroelectronics
STMicroelectronics LIMITED.

第二場次 SiC長晶材料/製造與加工

Yole Développement
Claire Troadec
Director, Power & Wireless

環球晶圓
林欽山 Sam Lin
Director
GLOBALWAFERS CO., LTD.

DISCO
劉建廷 Eddie Liu
Sales Manager
DISCO HITEC TAIWAN.

碳矽電子
李坤彥 Kung-Yen Lee
Professor
SICEV ELECTRONICS CO., LTD.

盛新材料
林柏丞 Kris Lin
Special Assistant of CTO
TAISIC MATERIALS CORP.

ULVAC
張家棟 Jacky Chang
Senior Manager
ULVAC TAIWAN INC.

國立陽明交通大學
郭浩中 Hao chung Kuo
National Yang Ming Chiao Tung University

活動好禮!!

所有參加上午場次者 有機會抽中
AirPods Pro
Beats Studio Buds 真無線藍牙耳機

主辦單位: TEEIA 台灣電子元件協會 國立陽明交通大學 TCUA 台灣化合物半導體國際論壇

協辦單位: ULVAC KLA AECM CHU HANWAT ARA ROHM ROHM

化合物半導體國際論壇

Applications of Compound Semiconductors

4.20 THU 13:40-17:00

Yole Intelligence
Taguhi YE GHOMYAN
PhD
13:40-14:00 Water Ink Equipment Overview for Compound Semiconductor Processing.

碳矽電子
李坤彥 Kung-Yen Lee
14:00-14:40 矽化鈾在 6G/5G 通訊元件製造應用

Electroninks
Melis LeMieux
Researcher Co-Founder
14:40-15:00 Retail Complex Ink and Films for Addressable Non-ferroelectric Advanced Packaging Applications.

Onsemi
江明雄 Mars Chiang
F&D Manager
15:00-15:30 矽化鈾在功率半導體製造應用

Soltec
Walter Schwarzenbach
PhD
15:30-16:00 SoltecSiC™: Engineered SiC for high-voltage power applications.

PALLIDUS
方建雄 Chien-Shyong Fang
General Manager
16:00-16:30 矽化鈾在功率半導體製造應用

抽獎資格:
凡參加活動者, 皆享有抽獎機會
< 獎品: AirPods 3rd-T-11 機會 >
抽獎時間: 4月20日(星期四) 13:40-17:00

晚宴「化合物半導體供應鏈之夜」

18:00-20:00 (贈送90名+邀請制)

立即報名

聯繫: TEEIA 林小姐 (Doris)
電話: TEL:02-27293933 #12 E-mail: doris@teeia.org.tw

贊助單位: ROHM, WolfSpeed, Infineon, ARA, YOLE, SICEV, electroninks, onsemi, soltec, KLA, ECM, CHU, HANWAT, ARA, ROHM, ROHM

化合物半導體國際論壇

Compound semiconductors challenges and future

4.20 THU 09:30-12:10

李振亞 Eric Lee
President of Yole Group
09:30-10:00 2022 半導體市場展望: 矽化鈾在功率半導體製造應用

WolfSpeed
許至全 Bruce Hsu
Director - Asia Regional Sales
10:00-10:30 矽化鈾在 6G/5G 通訊元件製造應用

英飛凌
Lucas Wei
Sales Director
10:30-11:00 SiC 在功率半導體製造應用: 技術分析

世界先進
彭建雄 Jeff Chiu
Deputy Manager
11:00-11:30 世界先進在功率半導體製造應用

DISCO
朱澤華 Shihwei Hsu
Product Manager
11:30-12:00 針對第三代半導體的 雷射加工技術

開幕導覽-化合物半導體供應鏈

Group guide-Compound Semiconductor Pavilion
12:10-12:40 (贈送20名自由報名)

18:00-20:00 晚宴「化合物半導體供應鏈之夜」
(贈送90名+邀請制)

抽獎資格:
凡參加活動者, 皆享有抽獎機會
< 獎品: AirPods 3rd-T-11 機會 >
抽獎時間: 4月20日(星期四) 13:40-17:00

立即報名

聯繫: TEEIA 林小姐 (Doris)
電話: TEL:02-27293933 #12 E-mail: doris@teeia.org.tw

贊助單位: ROHM, WolfSpeed, Infineon, ARA, YOLE, SICEV, electroninks, onsemi, soltec, KLA, ECM, CHU, HANWAT, ARA, ROHM, ROHM

—齊建構化合物 半導體生態圈

聯絡窗口：TEEIA 林芷廷 (Doris)
TEL：886-2-27293933 #12
FAX：886-2-27293950
E-mail：doris@teeia.org.tw